

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2024-026



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 关于对国家集成电路产业投资基金三期 股份有限公司投资的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日已签署《国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“基金”）出资人民币 215 亿元（以下简称“本次投资”）。

本次投资已经本行董事会审议通过，无需提交本行股东大会审议。
本次投资已经国家金融监督管理总局批准。

一、本次投资概述

近日，本行与中华人民共和国财政部等 19 家机构签署《发起人协议》，拟向基金出资人民币 215 亿元，持股比例 6.25%，预计自基金注册成立之日起 10 年内实缴到位。

本次投资不属于本行重大资产重组事项，不构成本行的关联交易。
本次投资已经本行董事会于 2023 年 11 月 30 日审议通过。议案

表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本行董事会审议通过上述议案时，本次投资尚未完成协议签署，基金尚未设立，存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》《中国建设银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的有关规定，本行经审慎判断，决定暂缓披露本次投资，并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

本次投资无需提交本行股东大会审议。

本次投资已经国家金融监督管理总局批准。

二、投资标的基本情况

基金由中华人民共和国财政部等 19 家机构共同出资设立，注册资本为人民币 3,440 亿元，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询等。基金旨在引导社会资本加大对集成电路产业的多渠道融资支持，重点投向集成电路全产业链。

三、本次投资对本行的影响

本次投资资金来源为本行自有资金。本次投资是本行结合国家对集成电路产业发展的重大决策、本行的发展战略及业务资源作出的重要布局，是本行服务实体经济、推动经济和社会可持续发展的战略选择，是本行践行大行担当的又一大举措，对于推动本行金融业务发展具有重要意义。

四、本次投资的风险分析

根据《发起人协议》约定，本行应自基金注册成立之日起 10 年

内按照认购的股份全额缴纳股款，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（2024年7月1日实施）等相关法律法规，上述出资期限安排尚需根据法律法规取得相关部门同意。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024年5月27日